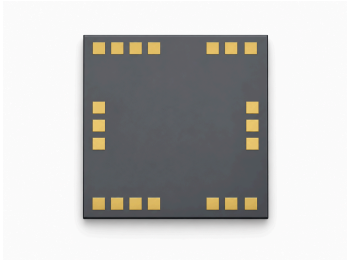


100–20000 MHz GaAs Die commutatore SP3T MMIC — $IL \leq 2.8\text{ dB}$ (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; Perdita di inserzione (100–2000 MHz) $\leq 1.4\text{ dB}$; Isolamento (100–2000 MHz) $\leq 65\text{ dB}$.



Caratteristiche RF · TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Frequenza operativa	f	100	-	20000	100–20000	MHz
Perdita di inserzione (100–2000 MHz)	-	-	-	1.4	f = 100–2000 MHz	dB
Perdita di inserzione (2000–20000 MHz)	-	-	-	2.8	f = 2000–20000 MHz	dB
Isolamento (100–2000 MHz)	-	-	-	65	f = 100–2000 MHz	dB
Isolamento (2000–20000 MHz)	-	-	-	43	f = 2000–20000 MHz	dB
VSWR di ingresso/uscita (attivo)	-	-	1.2	-	-	-
VSWR di ingresso/uscita (disattivo)	-	-	1.4	-	-	-
Potenza di ingresso alla compressione di 1 dB	-	23	-	-	-	dBm

Tensioni di controllo · TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità	Note
Corrente di riposo dell'alimentazione negativa	-	-	-	0.002	A	-
Corrente di pilotaggio in ingresso	-	-	0.0002	-	A	TTL = +5 V
Tensione di ingresso di livello alto	-	3	-	5.5	V	-
Tensione di ingresso di livello basso	-	0	-	0.8	V	-

Tensioni di controllo · TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità	Note
Tensione di alimentazione negativa	-	-5.5	-5	-4.5	V	-

Valori limite · Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Potenza di ingresso massima	-	-	-	25	dBm
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Temperatura operativa	-	-55	-	125	°C
Tensione minima di alimentazione negativa	-	-6	-	-	V

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	1.5 × 1.55 × 0.1	mm
Tolleranza del profilo in pianta	±100	µm

Assegnazione delle piazzole di bonding

Terminali	Simbolo	mm
2	RFin	0.100 × 0.100
9	RF1	0.100 × 0.100
12	RF2	0.100 × 0.100
15	RF3	0.100 × 0.100
4, 20	VEE	0.100 × 0.100
5, 7	A1	0.100 × 0.100
17, 19	B1	0.100 × 0.100
6	A2	0.100 × 0.100
18	B2	0.100 × 0.100
1, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 16	GND	0.100 × 0.100

Pubblicazione corrente · 1.4 · 2026-10-27. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.3.

Note di integrazione

A1 / B1 (V) = 0; A2 / B2 (V) = 0; RF = RFin ↔ RF1 A1 / B1 (V) = 0; A2 / B2 (V) = 5; RF = RFin ↔ RF2 A1 / B1 (V) = 5; A2 / B2 (V) = 5; RF = RFin ↔ RF3

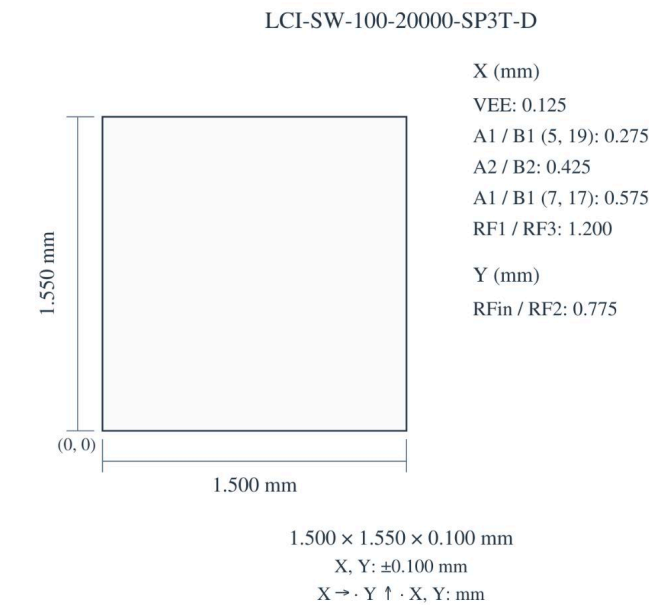
Collegamento delle piazzole

Le piazzole GND indicate sono punti di massa per il collaudo. Per VEE, è sufficiente usare una delle piazzole 4, 20. Per A1 / B1, è sufficiente usare una delle piazzole 5, 7, 17, 19. Per A2 / B2, è sufficiente usare una delle piazzole 6, 18.

Ambito del riferimento meccanico

Profilo e riferimenti delle coordinate quotate nella fonte, in mm. Non costituisce un disegno completo di fabbricazione o di wire bonding.

Disegno dimensionale meccanico

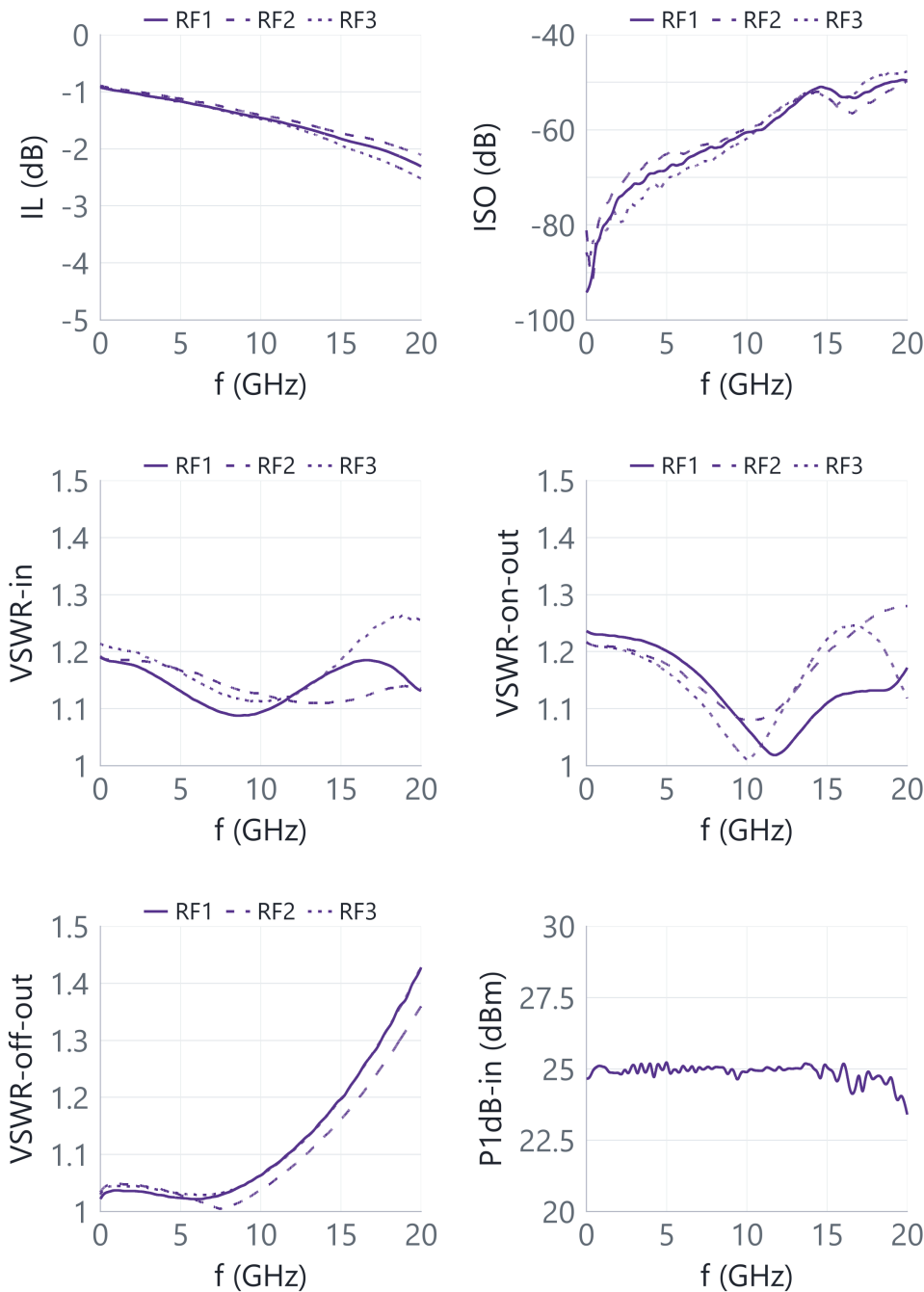


Tutte le dimensioni sono espresse in mm [in].

Curve di prestazione

Grafici tratti dalla scheda tecnica originale. Consultare ogni figura insieme alle condizioni operative indicate.

Adattamento d’uscita; Adattamento d’ingresso; Isolamento; Perdita di inserzione; Potenza di ingresso alla compressione di 1 dB.
Grafico ridisegnato dalla figura originale; i valori letti sono approssimativi.



[Fonte](#)

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.